

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2026-037

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月24日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年9月19日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司向参股子公司增加投资的议案》

上海道宜半导体材料有限公司（以下简称“上海道宜”）原系公司孵化项目，后独立发展并进行市场化融资，主营业务为环氧塑封材料。公司拟以自有资金合计3,000万元，通过直接增资及股权受让方式对其进行投资。其中，以6.68元/股的价格增资2,204.40万元，对应新增330万股；以4.68元/股的价格受让实际控制人顾海勇所持上海道宜170万股。本次投资完成后，上海道宜注册资本由6,942.60万元增至7,272.60万元。公司对上海道宜的认缴出资额由659.625万元增至1,159.625万元，直接持股比例由9.5011%提升至15.9451%。

经审议，董事会认为本次增资有利于推动双方技术、供应链及客户资源的有

效整合，使公司更有效地参与上海道宜重大经营决策，切实维护上市公司及全体股东的权益。此外，本次投资金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展，资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过。

特此公告

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日